

JASIS 2024 に出展いたします!

半導体をはじめ電池・材料・医薬品といった技術開発において、
 さまざまな試験課題の解決が必要となります。
 エスペックでは、信頼性が高く省スペースで最適な試験環境を
 実現できる評価試験装置をご提案いたします。



出展予定製品

温度

スポット冷却加熱装置 [Click](#)

試料を直接冷却・加熱し、チャンバーレスで温度特性評価が可能。温度変化速度100℃/分(空気温度)タイプをラインアップしております。



卓上型無風恒温槽 [Click](#)

AC100Vで使用可能、屈折率の低い観測窓を採用した無風恒温槽。半導体や実装基板の温度特性評価・熱解析の検証に最適です。



熱変形計測システム [Click](#)

3次元デジタル画像相関法(3D DIC)を組み合わせて、温度環境下における実装基板の反り変形量の可視化が可能。受託解析も承っております。



温度

湿度

スライド扉式小型環境試験器 [Click](#)

卓上に設置可能なコンパクトサイズの恒温槽にスライド扉やインターフェイスの装備が可能です。配線距離の短縮が図れ、測定精度の向上、配線作業の簡易化などに優れた試験装置です。



温度

湿度

圧力

高度加速寿命試験装置 [Click](#)

高温・高湿・圧力を同時に試料へ与えることで耐湿性評価が可能。小型化・高性能化する半導体の加速寿命試験に最適です。



会期	2024年 9月4日(水)~6日(金) 10:00~17:00
場所	幕張メッセ国際展示場 7ホール ブースNo. 7A-504

来場事前 [Click](#)
 入場のご案内



<https://www.jasis.jp/member/index.php?ltp=1>

●エスペック製品や技術に関するお問い合わせは

カスタマーサポートデスク 0120-701-678